

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	汎用 IC/ディスクリート	発行番号	TN-PKG-A102A/J	Rev.	第 1 版
題名	絶縁耐力に関する注意事項		情報分類	パッケージ変更	
適用製品	絶縁型パッケージ外形全製品	対象ロット等	関連資料	応用技術資料 TAG-1592	
		-			

ルネサスディスクリート絶縁型パッケージの絶縁耐力に関する取り扱い注意事項です。
 放熱フィン - 端子間の絶縁耐力を確保する為、放熱フィンは裏面全面を覆うものをご使用下さい。

放熱フィンが裏面全面を覆っていない場合、絶縁耐力保証値以内で放電が起きる可能性があります。

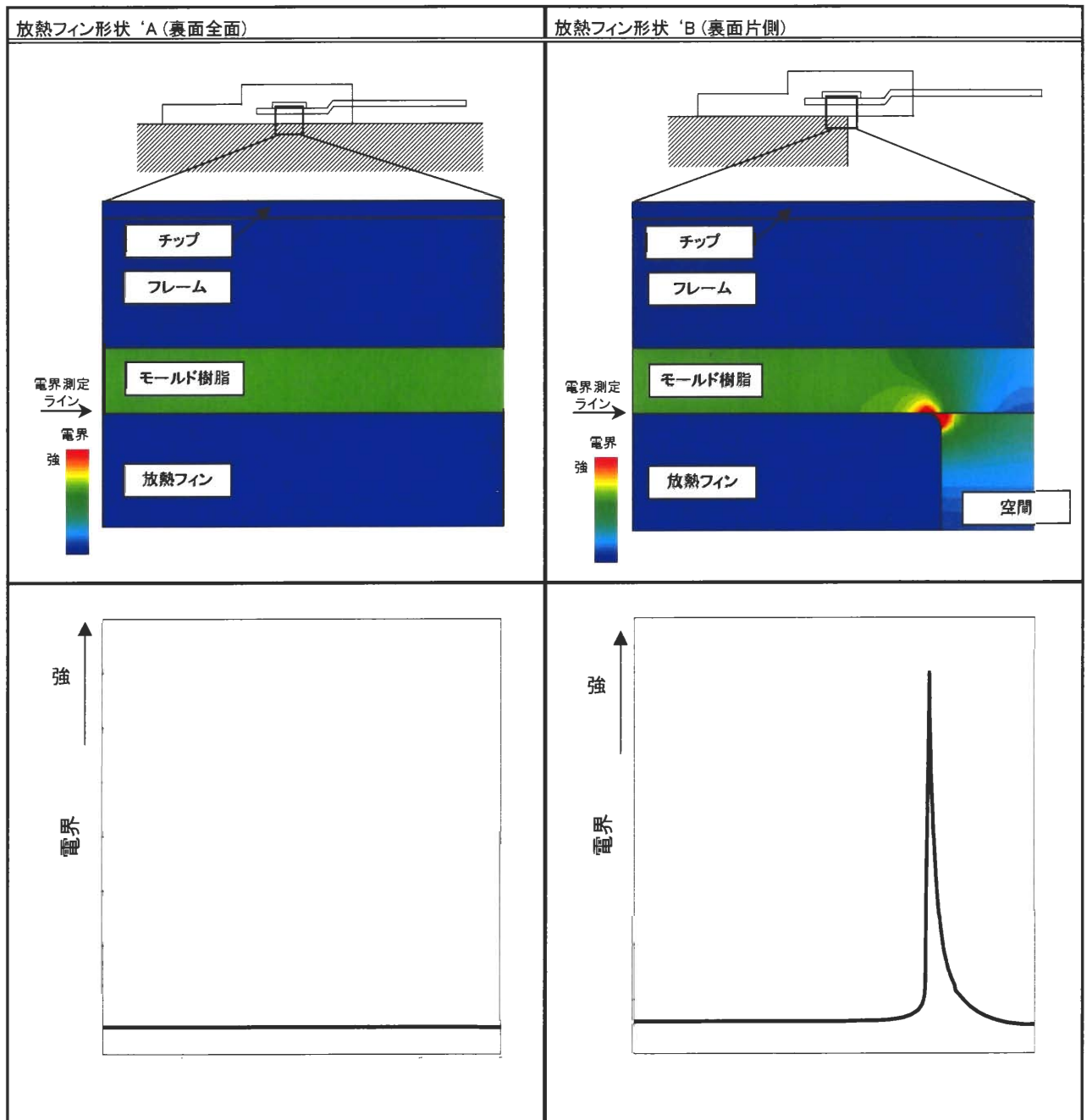
応用技術資料	作成	大谷	改定			
	検認	金子 107-31-21				

主 題 ルネサスディスクリート 絶縁型パッケージの説明

内 容 ルネサスディスクリート 絶縁型パッケージにつきまして、絶縁試験シミュレーション内容をご説明します。

放熱フィンが素子の裏面全面を覆っていない状態で使用すると電界が端部に集中し、絶縁耐力保証値以内で放電が起きる可能性がありますので、放熱フィンは裏面全面を覆うように取付け下さい。

1. 対象品種：ディスクリートデバイス
2. 対象外形：絶縁パッケージ品
3. シミュレーション内容



ディスクリート	TAG-1592	応用技術資料
---------	----------	--------